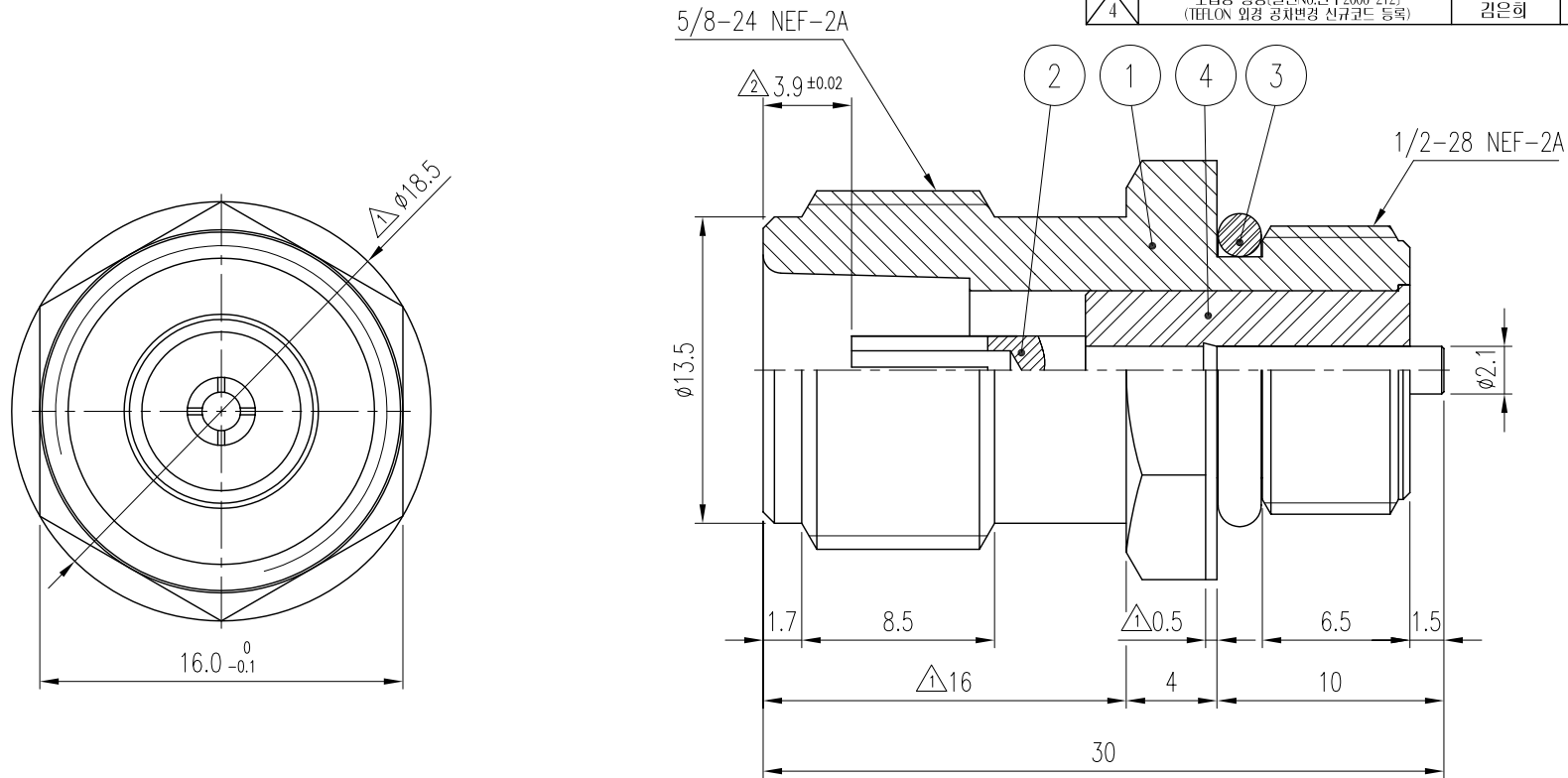


기 종 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											1	조립성 향상(BODY에 원형판넬 부착)	김은희	김준범	2005. 2. 1.
ST(개선)											2	신뢰성 향상(실변No.2005-140) (PIN값이 변경 4.401 → 3.9 ±0.02 도금 두께 변경)	김은희	유일환	2005. 5. 17.
											3	신뢰성 향상(실변No.2005-173) (N-TYPE PIN 표준화)	김은희	유일환	2005. 7. 6.
											4	조립성 향상(실변No.연구2006-212) (TEFLON 외경 공차변경 신규코드 등록)	김은희	윤상진	2006. 10. 26.



4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01001-N/1 DIN00684-N/1
3	GASKET	1	SILICONE RUB	P-10(9.8*1.9)	DGK00033-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate (내경7μm)	DCT00718-5/1
1	BODY	1	MBsBD	SILCO Plate (외경6μm)	DBD00953-5/1
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	품번	품 명			수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 소수 각도 분수 _____	년월일	2004. 11. 18.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인							
	_____	검도				도명 N-J-BR(PIMD 用) VER.4		
재질 _____	제도							
열처리 _____	검도							
보호파막처리 _____	작성부서			연 구 소	A4	도번	CN00803-7/1 K345-541-001	
	적도	NS	단위					mm